

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 二零二三年全年業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止全年業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命  
董事  
黃梓達

香港，二零二四年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



## ASMPPT 公布二零二三年全年業績

### 先進封裝業績穩健

#### 集團業績概覽

##### 集團財務概要: 二零二三年第四季度

- \* 銷售收入為港幣 34.0 億元(4.35 億美元), 按年-21.4%, 按季亦-2.0%
- \* 新增訂單總額為港幣 27.4 億元(3.50 億美元), 按年-12.2%, 按季亦-7.6%
- \* 毛利率為 42.3%, 按年+87 點子, 按季亦+812 點子
- \* 經營利潤率為 5.5%, 按年-825 點子, 按季則+356 點子
- \* 盈利為港幣 7,570 萬元, 按年-71.6%, 按季則+493.4%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.18 元, 按年-72.3%, 按季則+350.0%

##### 集團財務概要: 二零二三年

- \* 銷售收入為港幣 147.0 億元(18.8 億美元), 按年-24.1%
- \* 新增訂單總額為港幣 122.6 億元(15.7 億美元), 按年-33.5%
- \* 毛利率為 39.3%, 按年-186 點子
- \* 經營利潤率為 7.5%, 按年-920 點子
- \* 盈利為港幣 7.12 億元, 按年-72.8%
- \* 每股基本盈利為港幣 1.73 元, 按年-72.8%
- \* 於二零二三年十二月三十一日, 未完成訂單總額為港幣 66.1 億元(8.46 億美元)
- \* 二零二三年全年合計每股派息(包括特別股息)為港幣 1.39 元

##### 非香港財務報告準則計量<sup>1</sup>

- \* 二零二三年經調整盈利為港幣 7.45 億元(按年-71.5%), 及二零二三年第四季度為港幣 7,600 萬元(按季+68.4%, 按年則-71.3%)
- \* 二零二三年經調整每股基本盈利為港幣 1.82 元(按年-71.4%), 及二零二三年第四季度為港幣 0.18 元(按季+63.6%, 按年則-72.3%)

##### 二零二四年第一季度銷售收入預測

- \* 將介乎 3.7 億美元至 4.3 億美元之間, 以其中位數計按年-20.0%, 按季亦-8.1%

詳盡業績公布及投資者簡報可見於

<https://www.asmppt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

<sup>1</sup> 有關非香港財務報告準則計量之詳情, 請參閱載於集團詳盡業績公告的「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」。

(二零二四年二月二十八日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」 / 「集團」 / 「本公司」) (股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之業績。

由於宏觀經濟的不利影響，削弱了整體消費情緒意欲和對電子產品的需求，二零二三年對半導體行業而言是艱難的一年。儘管如此，集團憑藉其在半導體解決方案 (「SEMI」) 及表面貼裝技術 (「SMT」) 業務分部擁有獨有的廣泛產品組合，展現了出色的韌性。

## 集團二零二三年要點

- 全年銷售收入為港幣 147.0 億元 (18.8 億美元)，按年下降 24.1%。持續的經濟低迷對半導體解決方案分部構成不利影響，導致其銷售收入按年下降 37.0%，而表面貼裝技術解決方案分部則下降 10.0%，因汽車和工業終端市場的持續需求所帶動而保持韌性。這突顯了集團廣泛的業務組合優勢，因為其兩個分部遵循不同的業務週期，這在一定程度上幫助集團抵禦了下行週期所產生的影響。
  - 表面貼裝技術解決方案分部於二零二三年的銷售收入佔集團總銷售收入約 57%，於二零二三年第四季度已連續第六個季度錄得比半導體解決方案分部高的銷售收入。
  - 汽車市場繼續為集團總銷售收入作出最大貢獻，約為 22%。即使面對市場疲軟，集團全面的汽車解決方案及與不斷擴大的客戶群展開合作，令汽車市場維持強勁的貢獻。
  - 工業市場雖出現一些疲弱，但其貢獻百分比保持穩定，佔集團總銷售收入約 16%。受惠於智能工廠、綠色基礎設施、增強的自動化和數字化的結構性趨勢變化，其亦為表面貼裝技術解決方案分部業績的最大貢獻者。
- 全年新增訂單總額為港幣 122.6 億元 (15.7 億美元)，按年下降 33.5%，這是受半導體解決方案分部新增訂單總額於此下行週期按年下降 39.7% 所影響。由於表面貼裝技術解決方案分部於下半年開始常態化，下半年分部的新增訂單總額因而受到影響，導致二零二三年的新增訂單總額按年下降 27.7%。
  - 二零二三年先進封裝、汽車及工業的綜合新增訂單總額保持穩定，約佔集團新增訂單總額的 60%。
  - 集團未完成訂單總額於年底達港幣 66.1 億元 (8.46 億美元)，訂單對付運比率為 0.83。
- 集團的毛利率為 39.3%，下跌 186 點子，主要由於半導體解決方案分部的毛利率下降所致，而表面貼裝技術解決方案分部的毛利率則受惠於有利的產品組合錄得增長。
- 由於銷售量減少及毛利率下降，集團的經營利潤率按年下跌 920 點子至 7.5%。
- 隨著銷售收入及經營利潤率下降，集團經調整盈利按年下降 71.5% 至港幣 7.45 億元。

- 集團的資產負債表持續穩健，於二零二三年年底錄得強勁的現金和銀行存款達港幣48.0億元（二零二二年底：港幣44.2億元）。於二零二三年年底，淨現金創紀錄達港幣28.0億元（二零二二年底：港幣21.7億元）。
- 董事會建議派發特別現金股息每股港幣0.52元予股東。二零二三年度全年合計每股派息為港幣1.39元，派息率為80%。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「面對二零二三年充滿挑戰的宏觀經濟環境，ASMPT 仍展現了強勁的韌性和適應能力。除了汽車和工業終端市場的需求持續增長外，我們還看到了市場對集團先進封裝解決方案的需求不斷增加，以支持生成式人工智能及高性能計算等領域的新興應用。我們堅信先進封裝是一個具有巨大潛力的策略增長領域，並將優先投放資源於人才培養及產能，以進一步鞏固我們在市場的領先地位。ASMPT 充份佔據了把握人工智能市場機遇的有利位置，以實現長期的發展。」

### 表面貼裝技術解決方案分部 – 鞏固最大市場佔有率的強韌表現

即使處於更廣泛的半導體行業下行週期，在汽車和工業終端市場應用的推動下，表面貼裝技術解決方案分部仍錄得強勁的銷售收入表現。表面貼裝技術解決方案分部高端的配置及印刷工具需求強勁，訂單大部分來自歐洲及美洲的市場。人工智能相關伺服器應用對表面貼裝技術解決方案分部配置工具的需求亦不斷增加，同時，來自智能手機及可穿戴應用客戶的需求，特別是對表面貼裝技術解決方案分部的系統封裝（「SiP」）先進封裝工具的需求亦有增長。

### 汽車業務 – 銷售收入維持領先地位

汽車終端市場應用佔集團二零二三年總銷售收入的比率最高，約22%或約4.10億美元。

全面的汽車解決方案是ASMPT的競爭優勢。隨著新汽車製造商的加入和更多電動車型號的推出，電動車市場的增長勢頭明顯。集團與電動車企業的業務往來不斷增加，使集團的更多解決方案成為這些企業的工藝標準（「POR」）。

碳化矽（「SiC」）相關應用的需求亦持續增長，集團的「整體解決方案」包括晶圓的激光切割，固晶，加壓燒結，塑封以及表面貼裝技術解決方案分部的配置，幫助集團成為客戶首選的合作開發夥伴。

ASMPT預計於汽車終端市場應用的潛在市場將從二零二四年的約18億美元增長至二零二八年的26億美元，年均複合增長率約為10%。

## **先進封裝（「AP」） – 在高速增長的市場領域拓展更廣泛的客戶群**

二零二三年的先進封裝解決方案佔集團總銷售收入的百分比按年上升至約22%，或約4.10億美元。集團預計其先進封裝的潛在市場將從二零二四年的約17億美元逐步擴大至二零二八年的33億美元，年均複合增長率約為18%，主要受生成式人工智能市場的增長所推動。以下是一些要點：

**熱壓焊接（「TCB」）** 解決方案得益於強勁的未完成訂單，實現了年度最高銷售收入，對集團整體先進封裝銷售收入的貢獻最高。憑藉先發優勢，ASMPT 的 TCB 解決方案在市場處於領先地位，擁有全球最大的已安裝工具基礎。集團的 TCB 客戶群已拓展至邏輯垂直整合製造商之外，並已深深嵌入該等客戶的生成式人工智能供應鏈。集團憑藉來自一間領先晶圓代工和 OSATs 客戶獲得的重要訂單，在高性能計算和人工智能的 C2S 晶片到基底（「C2S」）和 C2W 晶片到晶圓（「C2W」）應用中均佔據主導地位。在高頻寬記憶體（「HBM」）市場方面，ASMPT 的工具已於一間領先公司投入生產。隨著與多家 HBM 客戶進行合作，集團憑藉其下一代超微間距 TCB 為 12H/16H 高頻寬記憶體做好準備。ASMPT 將繼續於二零二四年及以後進一步擴大生產能力以滿足日益增長的需求，從而把握生成式人工智能熱潮的機遇。

**覆晶（「FC」）高精確固晶** 工具在人工智能和高性能計算應用領域獲得青睞，其於二零二三年全年的訂單勢頭保持穩定，並預計將於二零二四年持續。集團的覆晶工具已具備應用於人工智能邊緣計算裝置的較小尺寸面板級扇出取放的處理能力。集團繼續與領先晶圓代工、高頻寬記憶體和 OSAT 客戶就 C2W 晶片到晶圓及 C2S 晶片到基底業務開展合作。

ASMPT 的 TCB 及覆晶工具已能夠在雲端和數據中心層面上滿足了人工智能客戶的需求，並已準備好利用人工智能邊緣計算設備的巨大需求發展潛力。

**混合式焊接（「HB」）** 方面，於二零二三年首次獲得用於 3D 集成的兩部工具訂單，並將於二零二四年下半年交付。集團下一代混合式焊接工具與主要客戶在包括記憶體市場的不同終端市場應用中的合作進展順利，集團有信心將於二零二四年第一季度及以後獲得更多混合式焊接工具的訂單。因此，集團有信心把握大批量生產（「HVM」）混合式焊接的機遇。

**光子**方面，生成式人工智能的高速增長促使帶寬需求增加，數據中心亦相應的不斷擴展和升級以作支援，令對更高帶寬的光學收發器和共同封裝光學（「CPO」）應用的需求亦不斷增長。ASMPT 領先市場的光子解決方案可滿足從 100G 到 800G 甚至更高帶寬的需求，同時，對於共同封裝光學的應用，集團的矽光子（「SiPh」）解決方案具有行業一流的配置精度及能夠處理多個焊接流程的高度靈活系統。集團的光子解決方案於二零二三年獲得領先人工智能客戶的重複訂單，並預期在二零二四年持續該訂單勢頭。

集團的**進階顯示屏**設備涵蓋小型及微型 LED 應用。隨著消費者意欲改善，加上無縫、高解像度室內電視牆 RGB 顯示屏大批量生產的潛力增長，令二零二三年下半年業務表現有所改善和訂單流入勢頭有所增加，並預期此勢頭將持續至二零二四年。ASMPT 的小型 LED 解決方案憑借其超微間距焊接的能力，充分佔據了把握有關需求增長的有利位置，同時，微型 LED 解決方案亦正逐漸地被大規模市場採用，包括在智能手錶和汽車等各種應用領域。事實上，集團是首間獲得微型 LED 智能手錶應用訂單的設備供應商。隨著對高端汽車智能車頭燈的需求持續增長，集團亦接獲此類車頭燈的訂單。

集團亦正與客戶進行合作，推出具有更高的配置準確度，多晶片拾取能力，以及可直接從晶圓上拾取晶片表現更好的新一代**表面貼裝技術解決方案分部先進封裝**工具。隨著這些工具在系統封裝、晶圓級別扇出及嵌入式基板應用中越來越廣泛，表面貼裝技術解決方案分部預計二零二四年集團將獲得更多先進封裝工具訂單。

### **集團二零二三年第四季度要點**

集團銷售收入為港幣 34.0 億元 (4.35 億美元)，略高於先前發布的銷售收入預測的中位數，按季下降 2.0%，按年亦下降 21.4%。

新增訂單總額為港幣 27.4 億元 (3.50 億美元)，由於表面貼裝技術解決方案分部，按年錄得下降 12.2%，同時由於一般季節性因素，按季下降 7.6%。

毛利率為 42.3%，分別按季錄得上升 812 點子，按年錄得上升 87 點子。由於第三季度的毛利率過低及受惠於半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部產品組合的改善，毛利率按季錄得上升。集團經調整盈利為港幣 7,650 萬元，按季上升 68.4%，按年則下降 71.3%。

### **股息**

ASMPT 的股息政策為將其每年約 50%的年度盈利用作派息並強調以股息形式將剩餘現金回饋股東。經考慮集團的短期資金需要和現時的現金水平，董事會議決建議向股東派發末期股息每股港幣 0.26 元 (二零二二年：末期股息每股港幣 1.90 元)。此外，董事會亦建議派發特別現金股息每股港幣 0.52 元予股東。連同已於二零二三年八月派發之中期股息每股港幣 0.61 元 (二零二二年：每股港幣 1.30 元)，集團於二零二三年度全年合計每股派息為港幣 1.39 元 (二零二二年：每股港幣 3.20 元)，派息率為 80%。

## 前景及二零二四年第一季度銷售收入預測

集團預期二零二四年第一季度的銷售收入將介乎 3.7 億美元至 4.3 億美元之間，以其中位數計按年下降 20.0%，按季亦下降 8.1%。下降主要是由於表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額在二零二三年下半年開始放緩而銷售收入下降所致。

許多專家預計半導體行業將於二零二四年復蘇。這將繼而推動行業開啟下一個為期數年的上升週期。集團對其長遠前景持樂觀態度，並將憑其獨有的廣泛產品組合把握此行業機遇。集團的信心亦得到包括汽車電動化、智能工廠、綠色基礎設施、5G/6G、物聯網及於雲端、數據中心和人工智能邊緣計算裝置的人工智能增長的長期結構性趨勢所支持。

### 關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT 是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT 在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 <https://www.asmpt.com/>。

### 前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電話：+65 6450 1445

電郵：[eg.lim@asmpt.com](mailto:eg.lim@asmpt.com)

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣

電話：+852 2864 4812 / 2864 4862

傳真：+852 2527 1196

電郵：[mandy.go@sprg.com.hk](mailto:mandy.go@sprg.com.hk) / [vivienne.leung@sprg.com.hk](mailto:vivienne.leung@sprg.com.hk)